

# Panier De Nettoyage Carré En Ptfé Pour Wafers, Rack De Gravure Pour Semi-Conducteurs En Fluoropolymère, Porteur De Wafers En Silicium Sur Mesure

Numéro d'article: PL-CP89



## Introduction

Optimisez les procédés de bancs humides pour semi-conducteurs avec nos paniers de nettoyage carrés en PTFE sur mesure. Conçus pour une résistance chimique extrême et une manipulation de haute pureté, ces porteurs en fluoropolymère offrent une durabilité et une précision supérieures pour la gravure et le nettoyage critiques de wafers de silicium.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Gravure de wafers de silicium	Immersion du substrat dans des agents de gravure acides pour éliminer les couches superficielles ou créer des textures spécifiques.	Résistance exceptionnelle aux mélanges d'acide HF et d'acide nitrique.
Nettoyage de cellules solaires	Nettoyage multi-étapes de grands wafers photovoltaïques carrés avant le dopage ou le revêtement.	Capacité de manipulation à grand volume avec un minimum de casse.
Traitement MEMS	Manipulation de systèmes micro-électromécaniques lors des étapes critiques de libération chimique.	Un environnement de haute pureté empêche la contamination microscopique.
Nettoyage ultrasonique	Utilisation dans des bains à ultrasons pour éliminer les particules sub-microniques de l'optique de précision ou de l'électronique.	Les propriétés d'amortissement protègent les pièces délicates des dommages vibratoires.
Analyse de traces métalliques	Préparation et nettoyage de la verrerie dans des bains d'acide à haute pureté pour la chimie analytique.	Interférence de fond la plus faible possible pour une détection au niveau PPB.
Manipulation de substrats LED	Support pour les wafers de saphir ou de carbure de silicium à travers des cycles de nettoyage et de rinçage agressifs.	Fiabilité à long terme dans les processus chimiques à haute température.
Stockage et transport chimiques	Confinement sécurisé de substrats sensibles pendant le transit entre les modules de salle blanche.	Les surfaces non réactives protègent la chimie de surface des wafers.
Recherche en laboratoire	Porteur de taille personnalisée pour le traitement expérimental de matériaux dans les laboratoires universitaires et de R&D.	Conception adaptable pour s'adapter aux configurations expérimentales non standard.

Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP89
Identification du modèle	PL-CP89
Dimensions standard	249mm x 249mm (Configuration carrée)
Composition du matériau	100% PTFE à haute pureté (Polytétrafluoroéthylène)
Compatibilité chimique	Universelle (Sauf métaux alcalins fondus et fluor élémentaire)
Plage de température	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)
Méthode de fabrication	Usinage CNC complet à partir d'un lingot massif

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP89	
Capacité de wafers	Entièrement personnalisable (Nombre et pas de fentes variables)	
Largeur de fente	Usinage de précision (Personnalisable selon l'épaisseur du wafer)	
Fonctionnalités de drainage	Ports de flux intégrés à la base et sur les côtés pour l'échange de fluides	
Options de poignée	Poignées en PTFE amovibles ou intégrées en option disponibles	
Finition de surface	Finition usinée lisse et non poreuse pour empêcher l'emprisonnement de particules	
Conformité	Conforme RoHS, matières premières de qualité FDA	